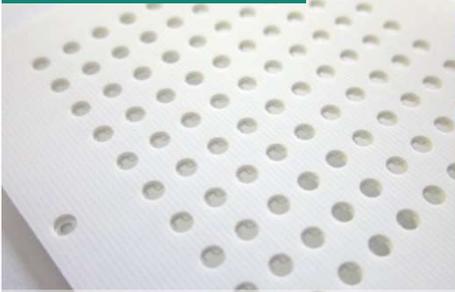
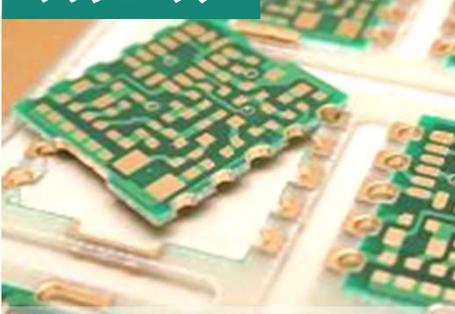
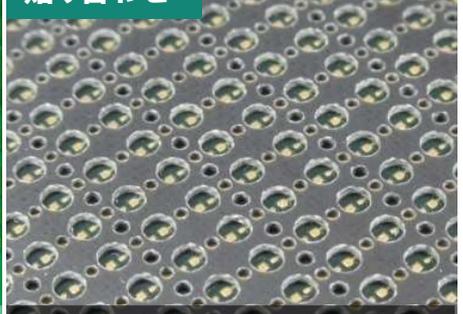


技術紹介

Our Technology



日本ミクロンの保有する様々な技術ノウハウを活用、組み合わせることによって、高密度化、薄型化といったプリント基板の新たな可能性を広げていきます。

<p>シリコン材加工</p>  <p>優れた耐変色性・高い反射率。貼り合わせとの組み合わせも可能</p>	<p>長穴レーザー</p>  <p>丸穴 長穴 丸穴・長穴での層間接続が可能です</p>	<p>ピン立て</p>  <p>半田を用いずに、リードピンを基板に固定</p>
<p>半裁スルーホール</p>  <p>製品外形に半裁スルーホールを形成でき、製品の小型化が図れます</p>	<p>フリップチップ</p>  <p>フリップチップ実装に対応した高密度基板を製造（$\varnothing 0.1\text{mm}$・$\varnothing 0.09\text{mm}$等）</p>	<p>リフレクター</p>  <p>リフレクター部分を貼り合わせ。底面部分とリフレクター部分の表面処理は変更可能</p>
<p>プッシュバック</p>  <p>当社独自の技術で反りを最小限に抑えます。半裁スルーホール・金属基板も対応します。</p>	<p>銅インレイ</p>  <p>基板に角穴加工し、同形状の銅ブロックを埋め込むことができます。</p>	<p>貼り合わせ</p>  <p>加工した基材を貼り合わせることでより構造体のパッケージを実現</p>



日本ミクロン株式会社

www.nihon-micron.co.jp

☎ 0266-23-8373

(土日・弊社指定休日を除く8:30~17:20)

✉ nmadpt@nihon-micron.co.jp

FAX 0266-23-1223

